

ザイメット高速フローリワーク可能なアンダーフィル、0.35mmピッチPOP用

2013年7月17日
ニュージャージー州イーストハノーバー

ザイメットは、0.35mmピッチパッケージの落下試験とボードレベルの信頼性を強化できる、新しいリワーク可能なアンダーフィル封止材 CN-1736v2を発表しました。流動性の速い低粘度流体です。さらに、フラックスの互換性が向上しているため、幅広いはんだペーストやフラックスでの使用に適しています。

より細かいピッチのデバイスでは、アンダーフィルの流れは遅くなります。0.35mmピッチのPOPに対して優れた流速を維持するために、CN-1736v2の粘度は700cpsです。また、ピッチの細かいはんだ接合部はより壊れやすく、アンダーフィルによる熱サイクル障害の影響を受けやすくなります。その結果、CN-1736v2は52ppm/°CのCTEで設計されており、これは以前の製品よりもはるかに低くなっています。

リワークは、170°C~180°Cの高温を使用してアンダーフィルフィレットを除去することによって行われます。次に、BGAは、リフロー温度まで加熱した後、ボードから持ち上げられます。アンダーフィルの残留物は、170°C~180°Cで簡単に削り取られます。

ザイメットは、マイクロエレクトロニクスおよび電子接着剤および封止材のメーカーです。その製品には、ダイアタッチ接着剤、基板接着剤、UV硬化型グロブトップおよびキャビティフィル封止材、アンダーフィル封止材などがあります。

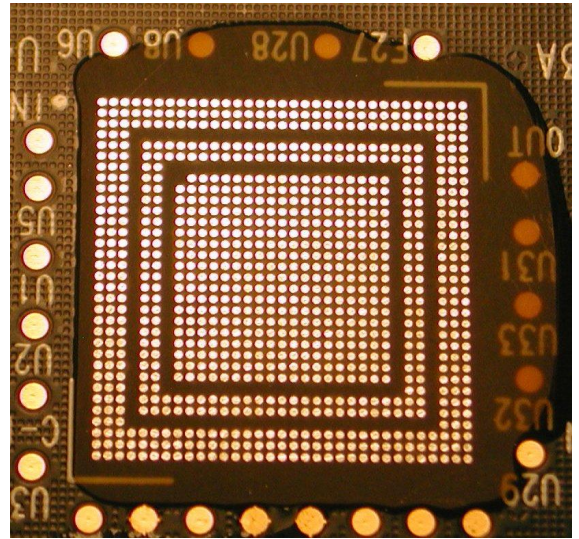


図1. CN-1736. ボイドフリーのアンダーフィル
0.4mmピッチPOP CN-1736